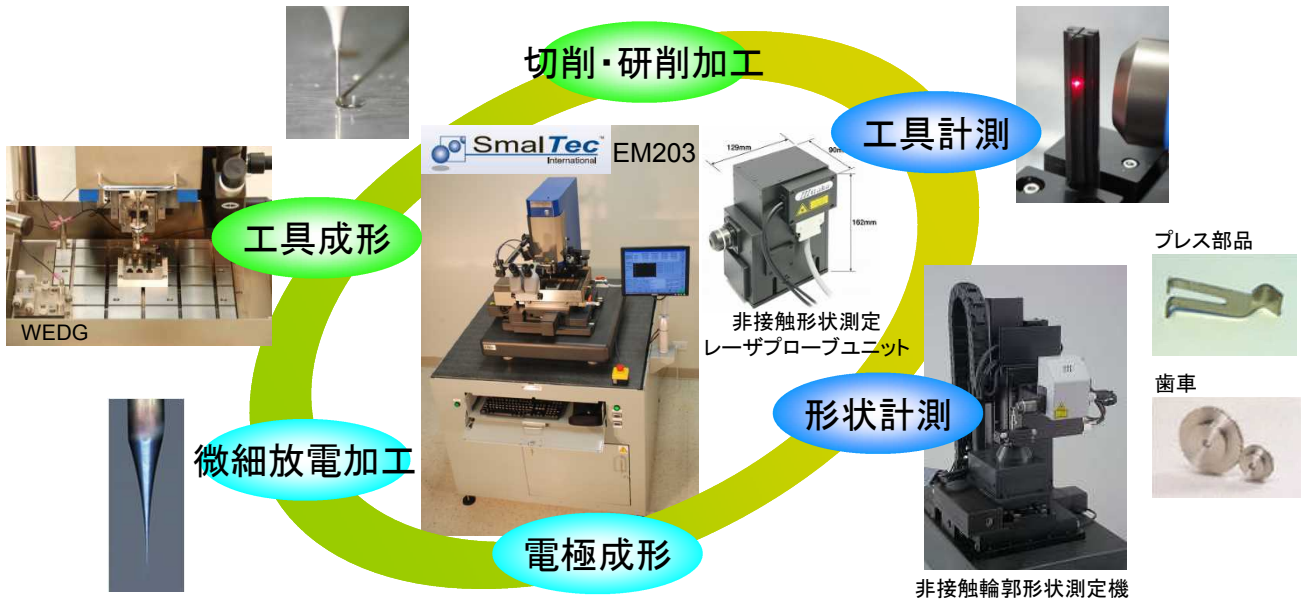
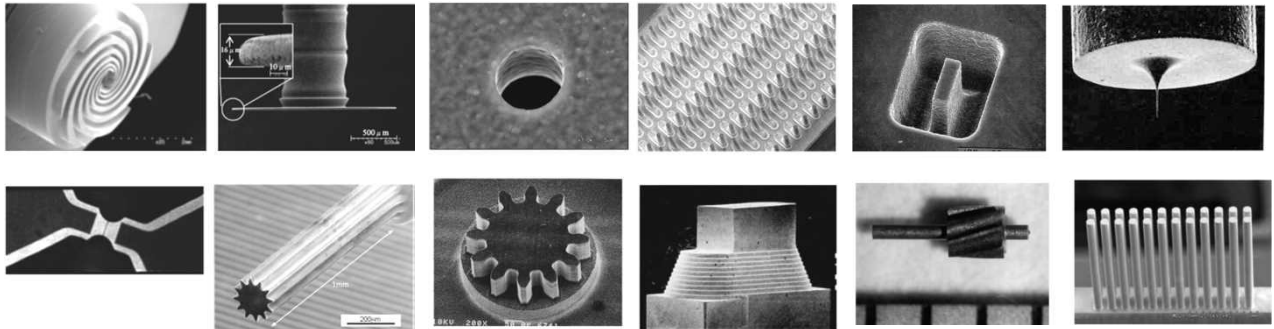


微細複合加工システム

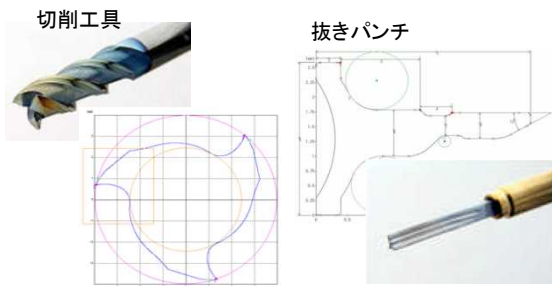
本装置は、高精度微細加工を目的として、マイクロ放電加工、微細切削・研削加工、マイクロ工具成形、機上形状測定機能を持った複合加工・計測システムです。リチウムイオン電池や太陽電池などの新エネルギー分野や情報・通信、医療関連分野など幅広い産業分野で利用される微細金型や微細部品の加工に利用できます。



■加工例: 様々なマイクロ部品や金型、工具などの加工が可能



■計測例: 複雑な輪郭形状の計測が可能



■主な仕様

加工部		計測部	
位置決め精度	1μm	計測方式	レーザープローブ
位置決め分解能	0.1μm	スポット径	1μm
最小パルス幅	5 ns	分解能	0.01μm
最小加工穴	φ3μm	傾斜面の計測	最大角度: 80度
工具成形機能	WEDG方式	オートフォーカス範囲	10 mm
主軸回転数	60,000 /min	測定サイズ	φ80 mm以下
加工範囲	X,Y: 200 mm Z: 95 mm	表面粗さ測定	JIS規格準拠

(本資料は、<http://tri-osaka.jp/fields/kakouseikei/#kikiannai> からダウンロード出来ます。)